

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2024 年 2 月 29 日 (29.02.2024)



(10) 国际公布号
WO 2024/041017 A1

- (51) 国际专利分类号:
H05K 7/20 (2006.01) **H05K 7/02** (2006.01)
- (21) 国际申请号: PCT/CN2023/090968
- (22) 国际申请日: 2023 年 4 月 26 日 (26.04.2023)
- (25) 申请语言: 中文
- (26) 公布语言: 中文
- (30) 优先权:
202211021806.X 2022 年 8 月 24 日 (24.08.2022) CN
202222249947.9 2022 年 8 月 24 日 (24.08.2022) CN
- (71) 申请人: 北京嘉楠捷思信息技术有限公司
(**CANAAN CREATIVE CO., LTD.**) [CN/CN]; 中国北京市
海淀区北清路 81 号院一区 1 号楼 20
层 2001 室, Beijing 100094 (CN)。
- (72) 发明人: 刘福兴 (**LIU, Fuxing**); 中国北京市海淀区
北清路 81 号院一区 1 号楼 20 层 2001 室, Beijing

- 100094 (CN)。张少华 (**ZHANG, Shaohua**); 中国北京市
海淀区北清路 81 号院一区 1 号楼 20 层 2001
室, Beijing 100094 (CN)。杨欢 (**YANG, Huan**); 中国
北京市海淀区北清路 81 号院一区 1 号楼 20
层 2001 室, Beijing 100094 (CN)。张楠赓 (**ZHANG,
Nangeng**); 中国北京市海淀区北清路 81 号院一区
1 号楼 20 层 2001 室, Beijing 100094 (CN)。
- (74) 代理人: 北京市铸成律师事务所 (**CHANG TSI &
PARTNERS**); 中国北京市西城区北展北街华远
企业号 A 座 6/7/8 层, Beijing 100044 (CN)。
- (81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家
保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG,
BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU,
CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ,
IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ,
LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN,

- (54) Title: ELECTRONIC DEVICE
- (54) 发明名称: 一种电子设备

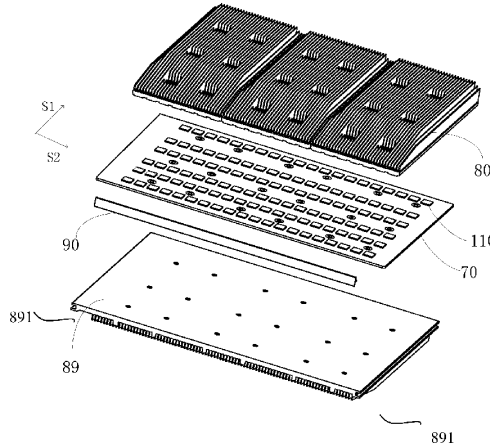


图 1

(57) Abstract: Provided in the present disclosure is an electronic device, comprising: a housing; a working assembly, installed in the housing, the working assembly comprising a circuit board and a heat dissipation component, and the circuit board comprising a substrate and a plurality of working chips arranged on the substrate; wherein the working assembly is detachably installed in the housing; a control panel, connected to the circuit board; and a power supply, used for supplying power to the circuit board. By means of the present technical solution, the heat dissipation characteristic and the power supply characteristic of the circuit board can be improved.

(57) 摘要: 本公开提供一种电子设备, 包括: 壳体; 工作组件, 安装于壳体内, 工作组件包括电路板和散热器, 电路板包括基板以及设置于基板上的多个工作芯片; 工作组件可拆装地安装于壳体内; 控制板, 与电路板连接; 电源, 用于为电路板供电。本公开的技术方案可以提高对电路板的散热特性和供电特性。

[见续页]

MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布：
— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。